

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2005 年 3 月 24 日 (24.03.2005)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2005/027597 A1

- (51) 国際特許分類⁷: H05K 1/03 (74) 代理人: 森本 義弘 (MORIMOTO, Yoshihiro); 〒5500005 大阪府大阪市西区西本町 1 丁目 1 〇 番 1 〇 号 西本町全日空ビル 4 階 Osaka (JP).
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2004/013603
- (22) 国際出願日: 2004 年 9 月 10 日 (10.09.2004)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願2003-317635 2003 年 9 月 10 日 (10.09.2003) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): ユニチカ株式会社 (UNITIKA LTD.) [JP/JP]; 〒6600824 兵庫県尼崎市東本町 1 丁目 5 〇 番地 Hyogo (JP). 日本化薬株式会社 (NIPPON KAYAKU KABUSHIKI KAISHA) [JP/JP]; 〒1028172 東京都千代田区富士見 1 丁目 1 1 番 2 号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者; および
- (73) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 越後 良彰 (ECHIGO, Yoshiaki). 江口 寿史朗 (EGUCHI, Jusirou). 繁田 朗 (SHIGETA, Akira). 内田 誠 (UCHIDA, Makoto). 茂木 繁 (MOTEKI, Shigeru).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).
- 添付公開書類:
— 国際調査報告書
- 2 文字コード及び他の略語については、定期発行される各 PCT ガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: SUBSTRATE FOR FLEXIBLE PRINTED WIRING BOARD AND METHOD FOR MANUFACTURING SAME

(54) 発明の名称: フレキシブルプリント配線板用基板及びその製造方法

(57) Abstract: Disclosed is a substrate for a flexible printed wiring board which comprises an adhesive layer composed of an epoxy resin composition, a pair of insulating layers which are respectively superposed on either side of the adhesive layer and made of a film composed of a non-thermoplastic polyimide resin, and conductive layers respectively formed on the outer surfaces of the films. The total thickness of the insulating layers superposed on both sides of the adhesive layer is 10-100 μ m and 2-10 times as thick as the adhesive layer. The adhesion strength between the insulating layers via the adhesive layer is not less than 7.0 N/cm.

(57) 要約: フレキシブル配線板用の基板であって、エポキシ樹脂組成物からなる接着層と、接着層の両面にそれぞれ積層されるとともに、非熱可塑性ポリイミド樹脂からなる一対のフィルムにて形成された絶縁層と、各フィルムの外表面に設けられた導体層とを備え、接着層の両面に積層された絶縁層の全体の厚みは、10~100 μ m であるとともに前記接着層の厚みの 2~10 倍であり、接着層を介した絶縁層同士の接着強度が 7.0 N/cm 以上である。

WO 2005/027597 A1